

半导体晶片切割保护膜 UV中转膜 UV照射失粘膜

产品名称	半导体晶片切割保护膜 UV中转膜 UV照射失粘膜
公司名称	东莞市新鹏达胶粘制品有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	材质:PO 厚度:0.11-0.175 粘性:1800克
公司地址	东莞市长安镇厦岗社区福海市场西街3号五楼D区
联系电话	13798763372

产品详情

本公司可提供定制材料长度、宽度，分条，复卷，模切，卷料，规格，可按照客户提供的图纸、样板定做。

样品说明：可免费提供，样品提供时间为1天以内（特殊材料需收样品费）。

由于产品规格众多，此报价仅供参加，非最终报价，更多产品规格与具体报价敬请旺旺咨询或来电洽谈，我们竭诚为您提供最优质的服务！

UV是英文Ultraviolet Rays的缩写,即紫外线.紫外线(UV)是肉眼看不见的,是可见紫色光以外的一段电磁辐射,波长在10~400nm的范围。UV膜

的原理：在特殊配方的树脂中加入光引发剂

（或光敏剂），经过吸收紫外线（UV）光固化设备中的高强度紫外光后，产生活性自由基或离子基，从而引发聚合、交联和接枝反应，使树脂(UV涂料

、油墨、粘合剂等)在数秒内（不等）由液态转化为固态。(此变化过程称之为"UV固化")。在使用LED芯片时，将芯片放在UV膜上可以保持晶粒在切割中的完整.减少切割中所产生的崩碎.确保晶粒在正常传送过程中,不会有位移、掉落的情形.不会有残胶的现象.具有适当的扩张性.晶粒容易取下.水不会渗入晶

粒与胶带之间.用途:1.用在WAFER的切割。2.用于保护芯片的完好。3.用于WAFER的翻转和运输。

胶层厚度：0.05mm-0.3mm贴玻璃粘着力/UV前180度剥离力：800-1800克（9.8N/in）贴玻璃过UV后粘着力/UV后180剥离力：2-20克(0.02N/in)残胶状况：无残胶耐热性：-10℃*2hr/80℃*2hr适应温度：-10~80℃
标准尺寸（宽mm）：230mm、300mm、980mm、1070mm等等标准长度：100m/200m特性/用途：此保护膜照紫外线前粘性较强，经紫外线照射后，粘性大大降低，可轻易剥离*切割，主要用于玻璃切割、晶圆片切割、陶瓷切割、镜头芯片切割保护，使用紫外线固化胶水。保存期限：室温25℃.相对湿度65%.可保存12个月